

イオンミリング装置

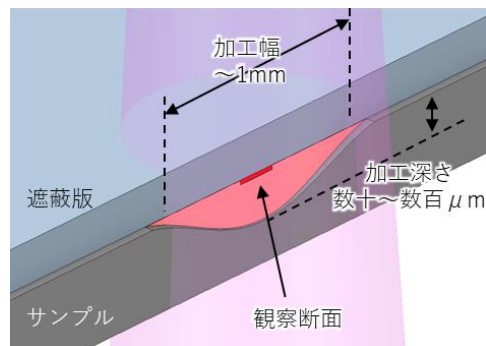
【日本電子(株)製 IB-19500CP】 平成28年1月導入



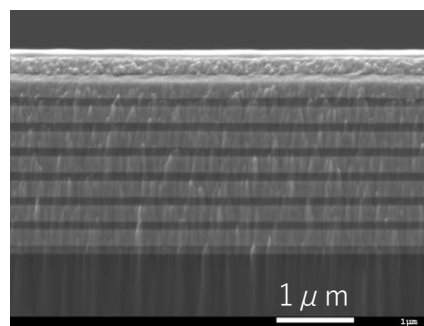
- ・イオンビームを用いてSEM、EPMA観察用の断面作製をする装置です。
- ・機械研磨と比較して加工ひずみやだれを抑えることが可能です。
- ・薄膜(積層膜やめっき)、硬くて脆い材料(セラミックスなど)、粉体、繊維など様々な材料の断面作製が可能です。

仕様	
加速電圧	2~8 kV
ビーム径	500 μm以上(半値幅)
ミリングスピード	6kV 約100μm/hr(間欠動作、試料によって変わります)
加工対象	固体(揮発成分を含むものは除きます) 例)電子部品,金属材料,ガラス等 ※試料によっては樹脂包埋など、前処理が必要となる場合がございます
最大試料サイズ	11mm(幅)×10mm(長さ)×2mm(厚さ)
試料移動範囲	X軸±10mm, Y軸±3mm, 回転±5°
使用ガス	アルゴンガス

【加工範囲の模式図】



【積層膜の断面観察】



使用方法	
	項目
委託試験	試料加工(イオンミリング)
設備使用	イオンミリング装置

担当部署：電子情報システム部